

Instrukcja montażu płytek

Dotyczy montażu płytek ceramicznych małych, średnio i wielkoformatowych (o wymiarze do 120x120 cm): gresowych, glazury, terakoty, klinkieru, mozaiki szklanej i ceramicznej.

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, np. kuchni, łazienki i pralnie, na korytarzach i schodach, balkonach i tarasach, cokołach. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Oznaczenia płytek Ceramstic

GL-199WL PS

Płytką typu glazura o nasiąkliwości wodnej >10%, GL-oznaczenie glazury, płytką ścienną, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, 199-indeks płytki, WL- płytką ścienną, PS- powierzchnia z połyskiem,

Możliwe inne oznaczenia S-powierzchnia satynowa, M- powierzchnia matowa,

GRS.420A.P

Płytką szklioną typu gres o nasiąkliwości wodnej <0,5%, GRS- oznaczenie gresu, płytką jest uniwersalna na ścianę i posadzkę, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, A- oznaczenie wzoru i koloru, P- powierzchnia z połyskiem.

Możliwe inne oznaczenia S-powierzchnia satynowa, M- powierzchnia matowa, L- powierzchnia lapatto, UL.122.ST

Płytką nieszkliwioną, barwioną w masie, typu gres o nasiąkliwości wodnej <0,5%, UL- oznaczenie gresu nieszkliwionego, 120- indeks płytki, płytką jest uniwersalna na ścianę i posadzkę, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, ST-powierzchnia strukturalna,

Możliwe inne oznaczenia A- oznaczenie wzory, P- powierzchnia z połyskiem, S-powierzchnia satynowa, M- powierzchnia matowa, L- powierzchnia lapatto,

DGL-252

Płytką dekoracyjną, typu glazura o nasiąkliwości wodnej >10%, DGL-oznaczenie dekoracji z glazury, płytką ścienną, do stosowania wewnątrz pomieszczeń, 252-indeks płytki, WL- płytką ścienną, PS- powierzchnia z połyskiem,

Możliwe są inne oznaczenia: S-powierzchnia satynowa, M- powierzchnia matowa, MTX-metalizowana, GRS DK-11

Płytką dekoracyjną, szklioną, typu gres o nasiąkliwości wodnej <0,5%, GRS- oznaczenie gresu szklionego, płytką jest uniwersalna, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

Możliwe są inne oznaczenia: A- oznaczenie wzoru, P- powierzchnia z połyskiem, S-powierzchnia satynowa, M- powierzchnia matowa, L- powierzchnia lapatto, ST- powierzchnia strukturalna.

DG-144B.M

Płytką dekoracyjną, szklioną, typu gres o nasiąkliwości wodnej <0,5%, DG- oznaczenie dekoracja z gresu, płytką jest na ścianę i posadzkę, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń,

Możliwe inne oznaczenia, B.M- oznaczenie wzory,

Mozaiki i dekoracje

MS.02, oznaczenia MS- mozaika szklana, 02- numer wzoru,

MK.001, oznaczenia MK- mozaika kamienna, 001, 19- numery wzorów,

MSK.05, oznaczenia MSK- mozaika szklano-kamienna, 05- numer wzoru,

MC.04, oznaczenia MC- mozaika ceramiczna, 04- numer wzoru,

MCM.21, oznaczenia MCM- mozaika ceramiczno-metalowa, 21- numer wzoru,

MGRS.1566, oznaczenia MGRS- mozaika gresowa, 1566- numer wzoru,

DS.67, oznaczenia DS.- dekoracja szklana, 87- numer koloru,

LS.87, LS- listwa szklana, 87-numer koloru,

LMT.01, LMT- listwa metalowa, 01- numer koloru,

LAL.02, LAL- listwa aluminiowa, 02- numer koloru.

Podłoża

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Odpowiednio przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne, tynki gipsowe, podłoża betonowe i posadzki cementowe, stare okładziny z płytek, przeciwwodne izolacje podpłytowe, podłoża z ogrzewaniem ściennym i podłogowym, jastrychy anhydrytowe i gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo włókniste, suche podłogi.

Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane (beton >3 miesiące, posadzki i tynki >28 dni).

Zalecana wilgotność podłoża <4%, cementowego <2%, gipsowego i anhydrytowego <0,5%, z ogrzewaniem <0,3%.

Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego wybudowane na pełne lub cienkowarstwowe spoiny.

Narzędzia i sprzęt

Poziomnica, łata, miętrowka, pion, niwelator krzyżowy, przecinarka płytek ręczna lub stołowa.

Mieszarka lub wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, paca zębata, paca gładka, szpachelka, kielnia. Pojemniki na klej i wodę. Miarka do wody, waga do kleju.

Krzyżyki dystansowe, system poziomowania,

Pace do fugowania, gąbki do profilowania fugi,

BHP

W trakcie prac stosować wymagane środki ochrony osobistej i odpowiednie ostony na sprzęcie mechanicznym.



Przygotowanie podłoża

Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć i dokładnie oczyścić. Duże ubytki lub nierówności na ścianach – otynkować, mniejsze uzupełnić zaprawą wyrównawczą. Na posadzkach zastosować wylewkę cienkowarstwową lub zaprawę wyrównawczą w zależności od głębokości ubytku. Podłoże słabe pomalować wzmacniającym gruntem głęboko penetrującym, podłoże wymagające zmniejszenia nasiąkliwości dedykowanym gruntem.

Stare okładziny z płytek, po ich uprzednim odtłuszczeniu i u szorstnieniu, przespachlować cienką warstwę kleju w celu stworzenia warstwy czepnej. Podłoża ogrzewane poddać procedurze wygrzewania zgodnie z zaleceniami producenta systemu grzewczego i/lub podkładu grzewczego.

Uwaga,

Zaleca się układać płytki ze spoiną o szerokości minimum 2 mm wewnątrz pomieszczeń oraz 5 mm na zewnątrz i na ogrzewaniu podłogowym.

Należy przenieść istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne na powierzchnię okładziny oraz zaplanować dodatkowe pola w zależności od miejsca ułożenia, przeznaczenia pomieszczenia i wielkości płytki.

Zaleca się stosować pola : 4-9 m² - dla okładzin na zewnątrz i korytarzy, 25 -35 m² dla okładzin na ogrzewaniu podłogowym, 50 m² dla pozostałych posadzek wewnętrznych.

Wyznaczyć płaszczyzny i linie pionowe i poziome dla rozplanowania układu płytek na podłożu.

Przygotowanie płytek

Przed ułożeniem płytek ceramicznych należy sprawdzić wymiary, jakość i płaskość powierzchni oraz jednolitość odcieni poprzez porównanie płytek ceramicznych z różnych opakowań. Po ułożeniu płytek reklamacje nie będą uwzględniane.

W celu wykluczenia pomyłki przy wydawaniu i transporcie towaru, należy porównać informacje znajdujące się na naklejkach, dotyczące: indeksu i nazwy płytki, kodu EAN, numeru partii, odcieniu i daty produkcji.

Uwaga,

Płytek nie moczyć przed klejeniem. Oczyścić spód płytek z zabrudzeń.

Płytki należy chronić przed działaniem czynników rysujących.

Uwaga,

Zapoznać się z ikonami dotyczącymi środków i zasad BHP.

Uwaga,

Zapoznać się z ikonami informacyjnymi, dotyczącymi typu i powierzchni płytki.



Płytki do okładzin ściennych

do okładzin podłogowych



Płytki podłogowa
Floor tile



Płytki ścienna
Wall tile



Powierzchnia matowa
Mat surface



Płytki rektyfikowana
Rectified tile



Płytki mrozooodporna
Frostproof tile



Powierzchnia satynowa
Satin surface



Powierzchnia lappato
Lappato surface



Efekt carvingu
Carving effect



Efekt metalizacji
Metallic effect



Płytki strukturalna
Structural tile



Powierzchnia polerowana
Polished surface

Uwaga,



Powierzchnia błyszcząca (do 96%)
Glossy surface



Nowość
new



Slim
5 mm



Ilość płytek w kartonie
Number of tiles
in a box

Uwaga,

Zaleca się sezonować zakupione płytki w pomieszczeniu, w którym będą układane, przez co najmniej dobę.

Uwaga,

Wszelkie prostokątne otwory w płytkach powinny być wycinane po wcześniejszym wycięciu otworów rozprężających.

Obróbka płytek, przecinanie, wiercenie otworów powinna odbywać się na wypoziomowanej płaszczyźnie.

Zaleca się stosowanie stołów montażowych.

Fazowanie pod kątem 45 stopni powinno odbywać się z zachowaniem min. 2 mm odległości od krawędzi płytki.

Przygotowanie kleju

Klej, Zaprawę klejową należy dobrać w zależności od rodzaju płytek, ich ciężaru, wymiarów i warunków, w jakich będą stosowane. Zaprawy klejowe należy stosować ściśle według instrukcji ich producenta.

Zawartość opakowania wsypać do pojemnika, zawierającego dokładnie odmierzoną ilość (podaną na opakowaniu), czystej i chłodnej wody, dla konsystencji standardowej lub rozpułwanej. Mieszać mechanicznie lub ręcznie aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny o założonej konsystencji. Po odczekaniu kilku minut wymieszać ponownie.

Przyklejania okładziny

Klej nałożyć na podłoże kielnią, gładką pacą lub szpachelką i rozprowadzić za pomocą pacy z zębami (prostokątnymi lub półokrągłymi) o wymiarach odpowiednich dla rodzaju i wielkości płytki. W miejscach niezabezpieczonych przed podciekaniem wody, należy nałożyć klej na podłoże i spodnią stronę płytki.

Uwaga,

W celu pełnego podparcia, zaleca się nakładać klej na podłoże i spód płytki.

Wszystkie płytki podłogowe, należy układać z pełnym podparciem, czyli min. 90%, na podłożu z ogrzewaniem 100% powierzchni pod płytką z klejem.

Płytki przykładać, dociskając lekko do podłoża. W ciągu czasu podanego na opakowaniu kleju, można skorygować położenie płytek. Przyklejanie wykonać w czasie nie dłuższym niż podanym dla danego kleju, od rozprowadzenia jego na podłożu.

Uwaga,

Do przyklejania płytek wielkowymiarowych stosować dedykowany osprzęt do ciecicia, przenoszenia i montażu płytek.

Płytki o długości boku ponad 80 cm, przenosić w zespole dwuosobowym i/lub za pomocą ramy z przyssawkami.

Uwaga,

Nie zaleca się układać płytek bez szczeliny (fugi), między nimi. Należy, stosować krzyżyki dystansowych o wymiarze odpowiednim dla wielkości płytki, rodzaju podłoża i miejsca zastosowania.

Uwaga,

Dla uzyskania równej płaszczyzny, zaleca się stosować systemy poziomowania. Dla płytek szkliwionych z połyskiem, należy stosować systemowe podkładki gumowe pod kliny, w celu uniknięcia rys powierzchniowych.

Uwaga,

Płytki typu deska podłogowa, o wymiarach np. 120x20 cm, należy układać z przesunięciem 1/3 długości. Nie zaleca się układać w jodełkę.

Uwaga,

Klej zaleca się zużyć w ciągu określonego czasu, od wymieszania z wodą. Czas zużycia podany jest na opakowaniu kleju.

Przedozowanie wody może wydłużyć czas wiązania oraz pogorszyć właściwości kleju, między innymi: zmniejszyć przyczepność i zwiększyć spływ.

Uwaga,

Świeże zabrudzenia zmyć wodą, stwardniałe pozostałości kleju usunąć odpowiednim środkiem chemii budowlanej i/lub mechanicznie.

Płytki należy chronić przed działaniem czynników rysujących.

Spoinowanie płytek

Klej lub zaprawa klejąca pod okładziną ceramiczną muszą być wyschnięte. Resztki kleju ze szczelin fug należy usunąć mechanicznie. Krawędzie płytek muszą być suche, wolne od zabrudzeń, kurzu i środków pogarszających przyczepność.

Uwaga,

Należy ze spoin usunąć krzyżki dystansowe i pozostałości systemów poziomowania.

Uwaga,

Zaleca się zawsze wykonać testy sprawdzające czy fuga nie zabrudzi powierzchni płytki.

Przygotowanie fugi

Uwaga,

Zapoznać się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu fugi. Stosować narzędzia i sprzęt zalecany przez producenta fugi.

Do pojemnika z odmierzoną ilością wody (podaną na opakowaniu spoiny) wsypać odpowiednią ilość proszku z torebki, wiaderka. Dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania bez grudkowej, plastycznej konsystencji. Odczekać kilka minut aby fuga dojrzała i ponownie przemieszać.

Wypełnianie spoin fugą

Zaleca się spoinowanie rozpocząć gdy klej, zaprawa klejowa, mocująca płytki będzie wyschnięta i odpowiednio związana. Powierzchnia szczelin między płytkami musi być czysta i wolna od kleju i zabrudzeń, w celu wyeliminowania możliwości powstawania przebarwień na powierzchni fugi.

Przed przystąpieniem do prac, za pomocą gąbki, zwilżyć szczelinę i krawędzie płytek wodą.

Używając szpachli gumowej, rakli, fugę nanosić ukośnie do spoin. Po czasie podanym na opakowaniu fugi, przystąpić do pielęgnacji wypełnienia. Przemycać powierzchnię płytek i fugi za pomocą wilgotnej gąbki, zamoczonej w wodzie. Należy często płukać gąbkę w wodzie. Po wyschnięciu spoiny, pozostałe zbrudzenia powierzchni, zmyć jeszcze raz gąbką z czystą wodą.

W zależności od temperatury i wilgotności powietrza czas zużycia gotowej mieszaniny spoinującej może być zmienny.

Podczas prowadzenia prac należy chronić fugę przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz przeciągami.

Wilgotnych fug nie należy czyścić na sucho, ponieważ można doprowadzić do zmiany ich koloru.

Po fugowaniu powierzchnie poziome chronić, przez czas wskazany na opakowaniu spoiny, przed ruchem pieszym.

Uwaga,

Zaleca się czyszczenie i pielęgnację przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych nie zawierających w swoim składzie proszków czyszczących.

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C. Chronić wykonaną okładzinę, zgodnie z zaleceniami producenta kleju i/lub spoiny, przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Uwaga,

W przypadku kontynuowania prac budowlanych, należy wykonane okładziny ceramiczne zabezpieczyć np. matą, kartonem, folią. Chronić przed zarysowaniami od urządzeń i sprzętów budowlanych.

Uwaga,

Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, zastosowania niewłaściwych klejów, zapraw klejowych i fugowych oraz środków czyszczących nie stanowią podstawy do uwzględnienia reklamacji.

Przechowywanie płytek

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach. Chronić przed zawilgoceniem, przemrożeniem i nasłonecznieniem w czasie transportu i składowania. Chronić przed uderzeniem, upuszczeniem. Opakowanie może być poddane recyklingowi.



Uwagi

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej $(50\pm 5)\%$. W innych warunkach parametry kleju i fugi, min. ich czas zużycia może ulec zmianie.

Po wymieszaniu z wodą klej i fuga dają odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe mechanicznie.

Producent gwarantuje jakość produktu, lecz z powodu braku wpływu na warunki i sposób użycia, nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

W razie wątpliwości dotyczących stosowania zaleca się przeprowadzić próby stosowania lub skontaktować się z producentem, www.rotberg.pl. Z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dane techniczne

W zamieszczonych na stronie www.ceramstic.pl kartach informacyjnych podane są parametry techniczne, wymiary i masa płytek, sposoby ich pakowania.

Data wydania instrukcji 01.12.2021 r. Niniejsza Instrukcja jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.